



第32回コンピュータシステム・シンポジウム (ComSys2020) 招待講演
2020/12/1

TEE (Trusted Execution Environment)は 第二の仮想化技術になるか？

須崎有康^(1,2)

- (1) セキュアオープンアーキテクチャ・エッジ基盤技術研究組合 (TRASIO)
- (2) 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 (AIST)
サイバーフィジカルセキュリティ研究センター (CPSEC)

おことわり

- TEEや仮想化を中心に話します。Root of Trustやremote Attestationも面白い話題がありますが、今回は詳細を割愛させていただきます。
- 参考資料
 - Trusted Execution Environmentによるシステムの堅牢化, 情報処理2020/06
<https://ci.nii.ac.jp/naid/40022255769>
 - Trusted Execution Environmentの実装とそれを支える技術, 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review, 2020/10
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/14/2/14_107/article/-char/ja/

研究背景

● TPM

- 振興調整費「組込みシステム向け情報セキュリティ技術（研究代表者：柴山先生、2006-08）」
- 日本IBMからの再委託(METI新世代情報セキュリティ研究開発事業、2007)

TPMによるRemote attestationを実現した。

● ARM TrustZone

- JST日台研究交流「偽造困難なデバイスを用いたIoTセキュリティ管理システム」(2015-17)

ACSAC2020論文
Reboot-Oriented IoTに結実

● RISC-V TEE

- NEDO AIエッジ(FY2018-2022)でRISC-V TEEのソフトウェア開発を担当
セキュアオープンアーキテクチャ・エッジ基盤技術研究組合 (TRASIO)が2019/08に設立



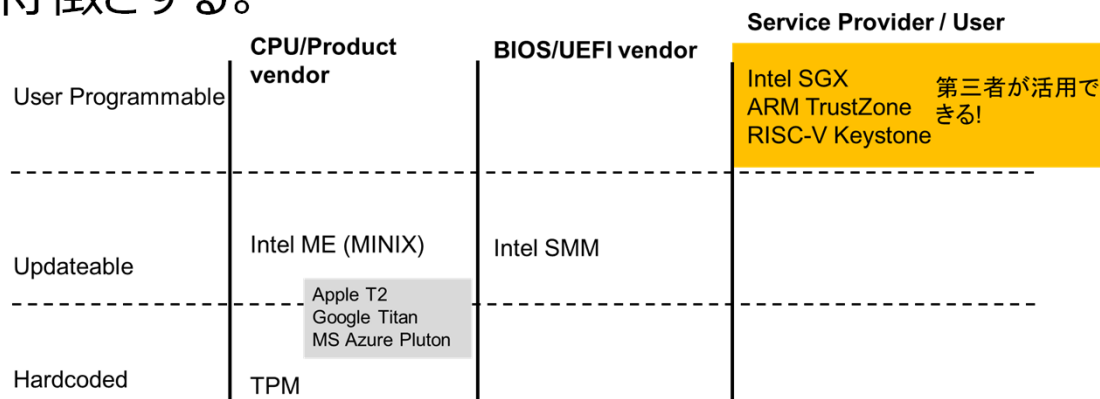
Open Source Summit Japan、
IEEE TrustCom論文に結実

Outline

- TEEとは
 - ハードウェアの特長
 - Arm TrustZone, Intel SGX, RISC-V Keystone(TRASIOのRISC-V TEE)
 - システムソフトの実装の違い
- 新しい方向
 - 仮想化対応
 - Arm-v8.4A TrustZone, AMD SEV, Intel TDX, Amazon Nitro
- その他
 - アンチテーゼ
 - 関連組織、規格
- まとめ

TEEとは

- HIEE(Hardware-assisted Isolated Execution Environments)の一つだが、**TEEは第三者がプログラミング可能**であることを特徴とする。



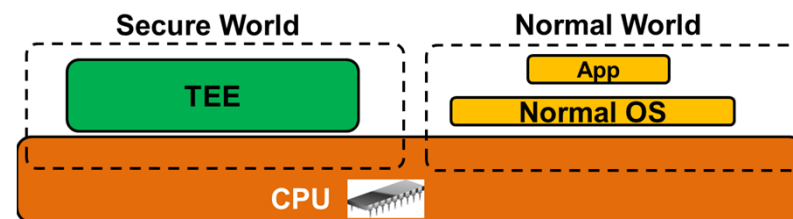
- **特徴：（極端に言えば）隔離実行されるのみで、単体ではRoot of Trustになりえない。**

- Root of Trustには安全に鍵・証明書を保存する耐タンパハードウェア(Secure ElementかSecure CoProcessor)が必要

- **これを信頼の基点にRemote Attestationが行われる**

- 利用できるハードウェア

- ARM TrustZone, Intel SGX, RISC-V Keystone



この図はあくまでTEEの一例 5

TEEの応用

- 機密情報処理
 - 鍵管理
 - AndroidのKeyMaster
 - DRM処理
 - スマホのWidevine(Google)
 - 個人情報管理
 - 指紋認証処理
- コード・データの隠蔽
 - 機械学習の重み付けデータ
 - プライバシー保護
 - 遺伝子解析
- 暗号処理の前提条件軽減
 - IRON[CCS'17]

- メモリ消費が少ない
- スマートフォン
- Arm TrustZone向き

- メモリ消費が大きい
- サーバ・クラウド
- Intel SGX、AMD SEV 向き

- RISC-V?

TEE分類

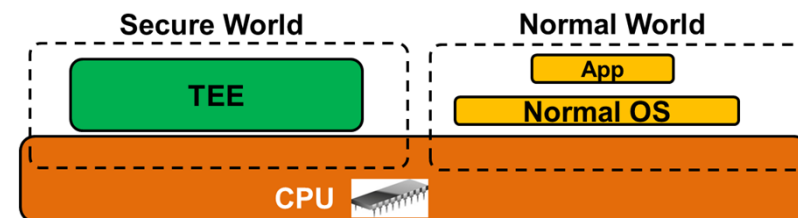
A Tale of Two Worlds[CCS19]での分類

● 2 World View Model

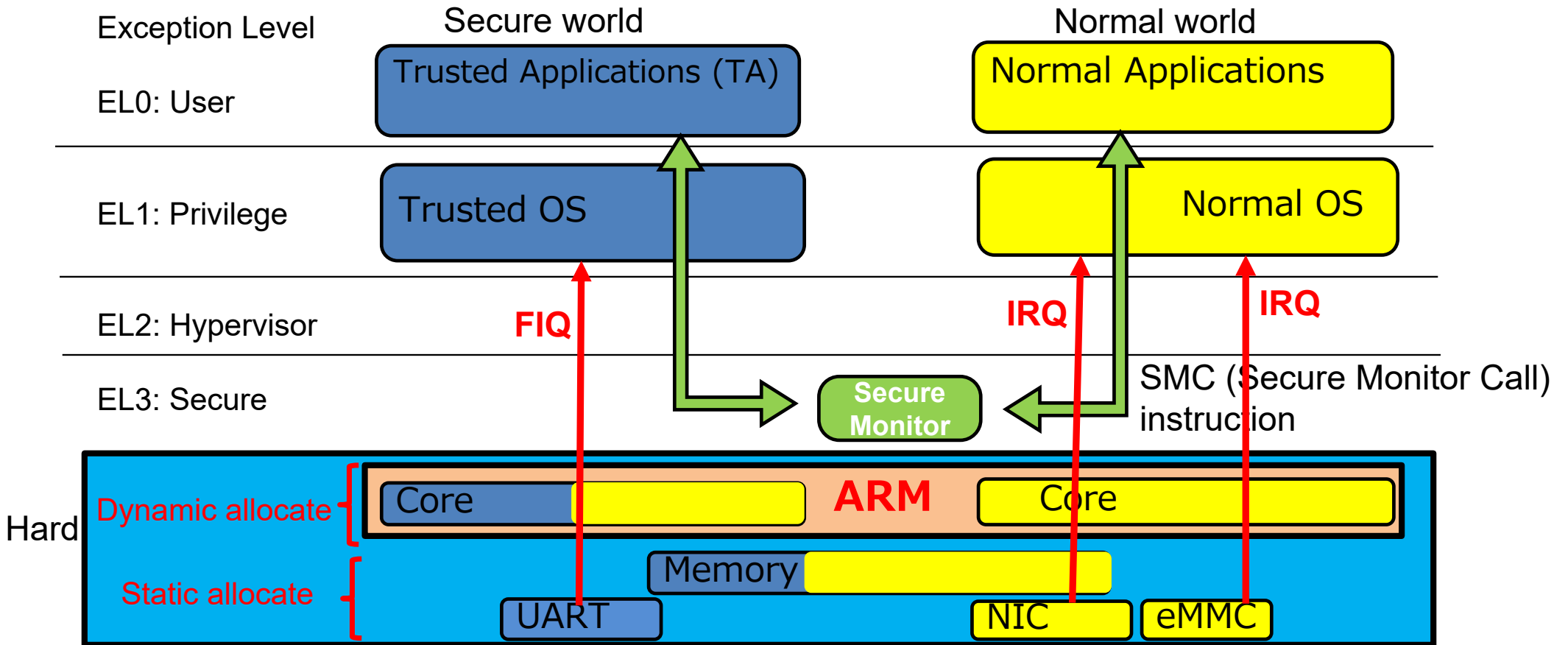
- Normal WorldとSecure Worldに分けられる。
- 各Worldでユーザ・カーネルモードがある。
- GlobalPlatformが定義しているアーキテクチャ
- 対応アーキテクチャ ARM TrustZone, RISC-V Keystone

● Single Address Model

- ユーザ空間のプログラムから直接TEEのEnclaveに切り替わる。
- 対応アーキテクチャ Intel SGX

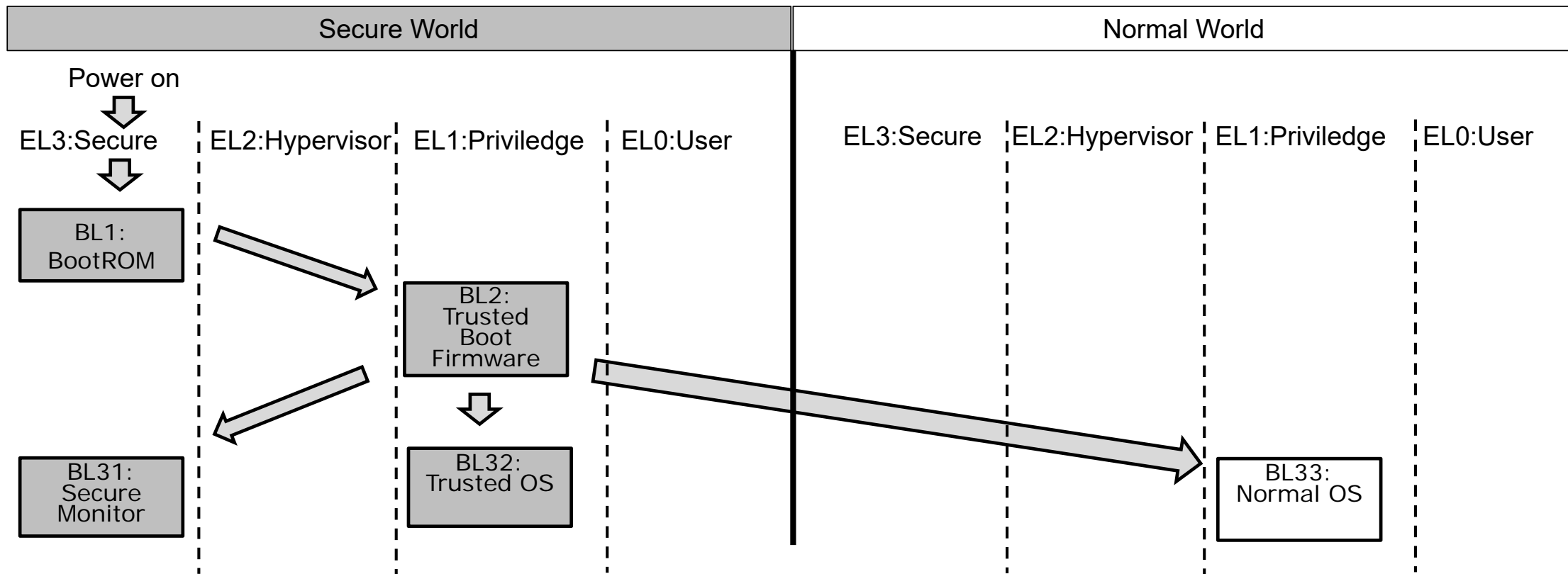


Arm Cortex-A TrustZone



Boot Sequence on ARM Trust Zone

- BL: Boot Loader
- EL: Exception Level



Intel SGX

- TEEであるEnclave内はRing3のみ。ユーザアプリのみの実行ができる
 - Intel SDKに従えばUntrusted側のプロセスの一部のライブラリ関数として実行される
 - OS相当の機能は単純に入れられない。(苦労して入れている)
- **SGX実装の大部分がMicro Code** (詳細は特許、講演資料から推測 Secure Processors Part I & II)
 - 追加ハードは PMH(Page Miss Handler)とMEE (Memory Encryption Engine)
 - Micro Codeでは実装が難しい部分には特殊Enclaveがある
 - Provisioning Enclave 鍵管理、Launch Enclave 生成管理、Quoting Enclave リモートアtestーション管理
- 使えるメモリは 1 Enclaveで96MB以下。(BIOSで確保は128MB以下)
 - 暗号化したメモリをEnclave外にswap outする仕組みあり

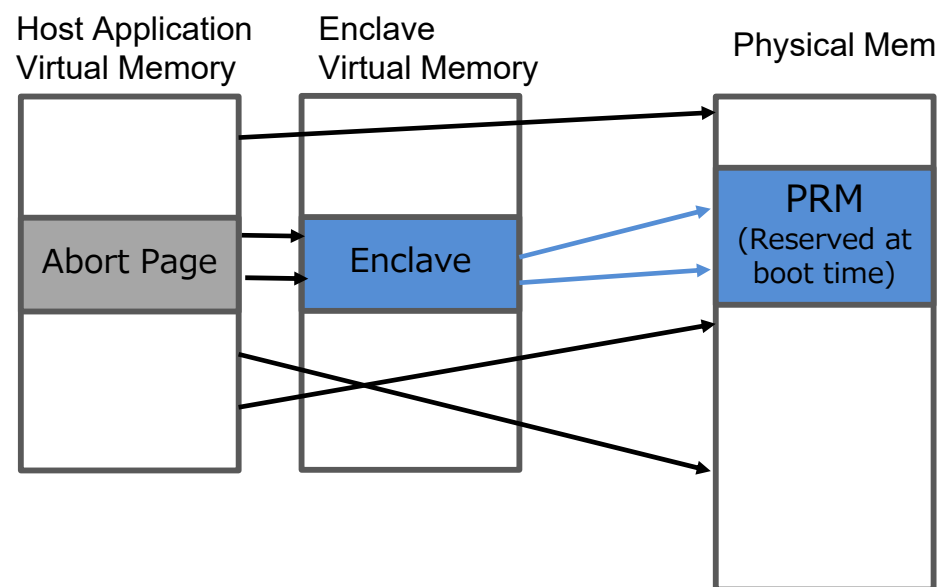
参考資料

Secure Processors Part I & II, Victor Costan, Iliia Lebedev and Srinivas Devadas **これはバイブル!**

https://people.csail.mit.edu/devadas/pubs/part_1.pdf https://people.csail.mit.edu/devadas/pubs/part_2.pdf

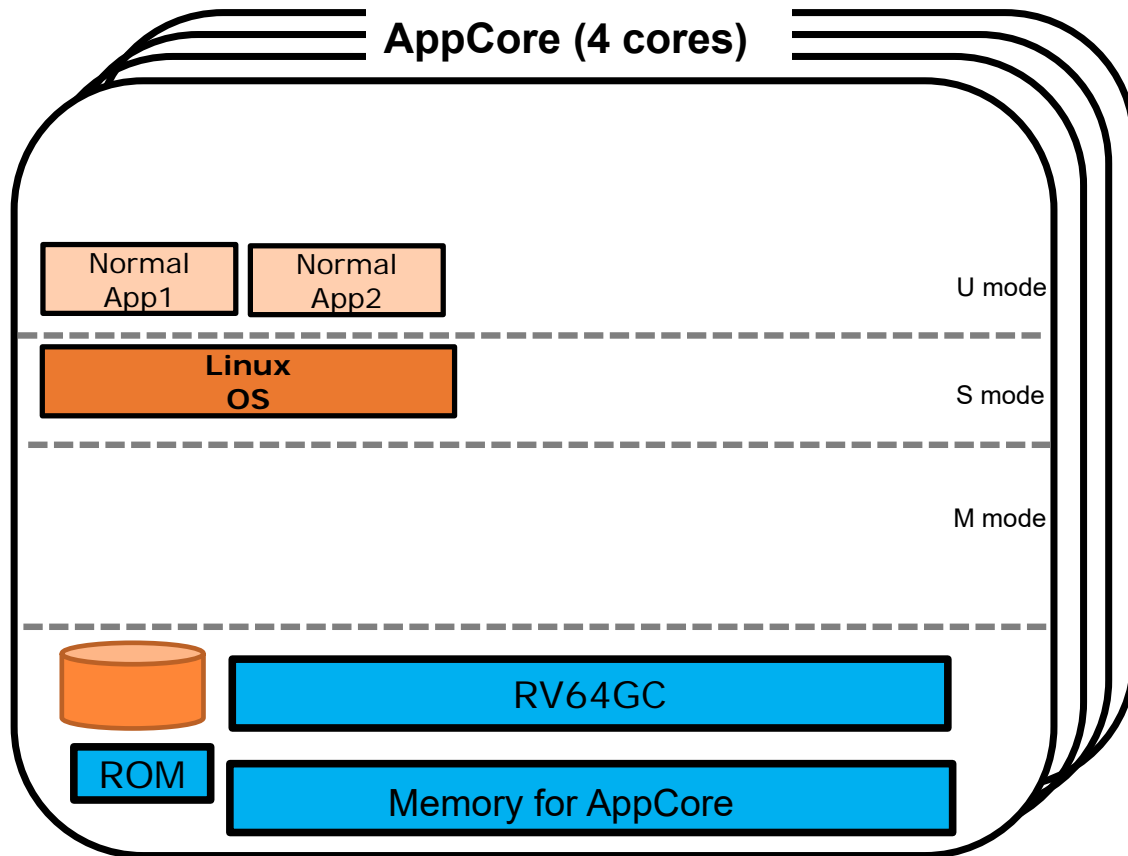
Intel SGX

- 通常のアプリの一部（ライブラリ関数）としてEnclaveで実行される
- Enclaveのメモリは別仮想空間となる。物理メモリとしてはEnclave用に確保した部分が使われ、暗号化される



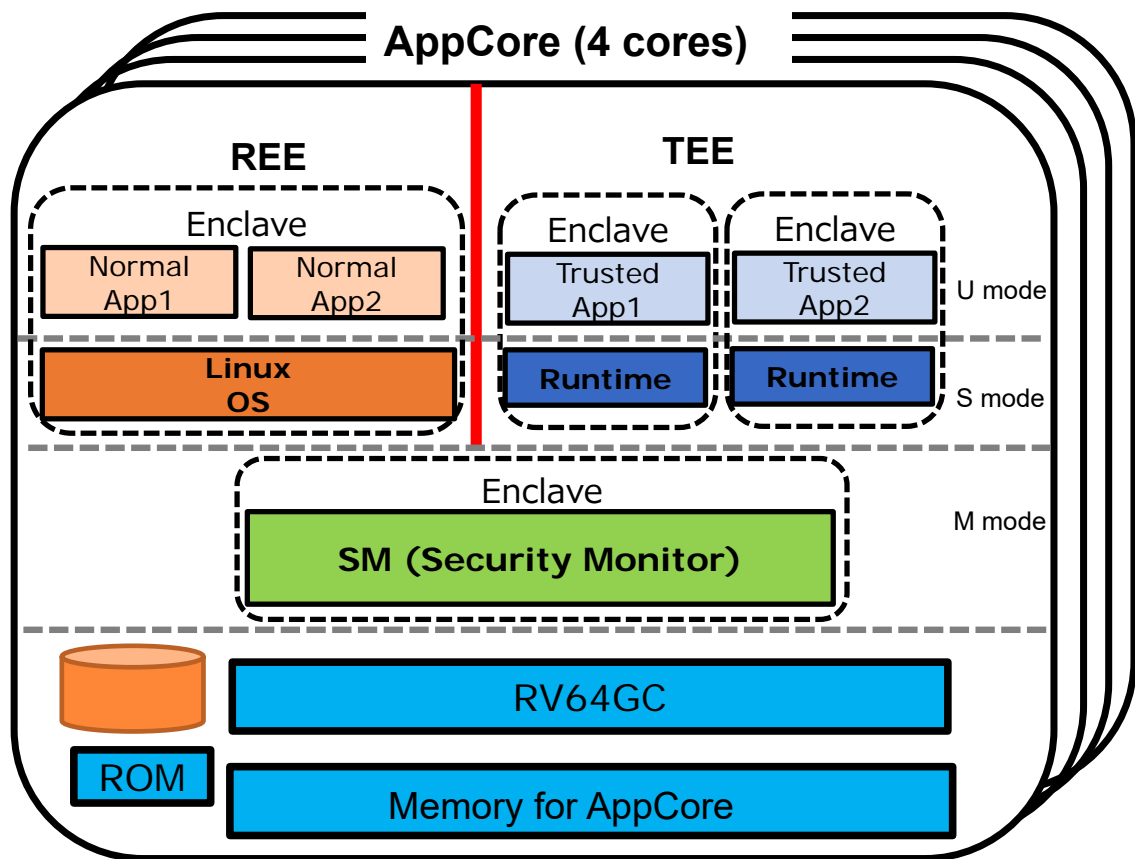
- PRM: Processor Reserved Memory BIOSで確保するメモリ

通常のRISC-V



- Rocketコアを想定
 - 割り込みはM modeに落ちるが
図中では省略

Keystoneを有効にしたRISC-V

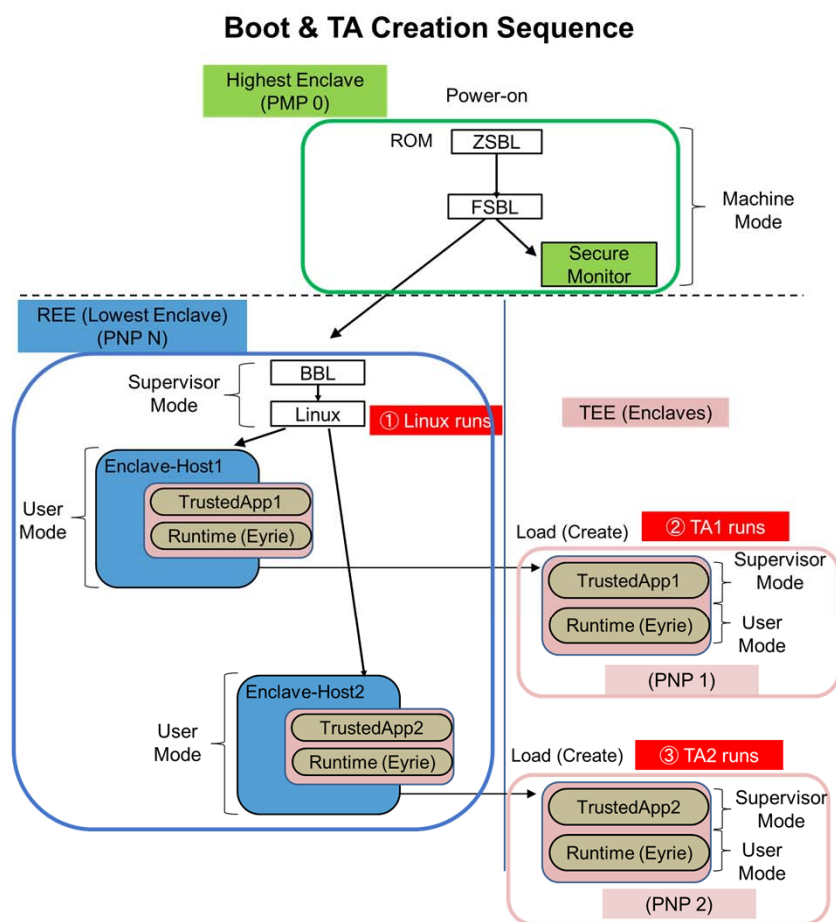


- ハードウェア的には変わりはない。
- PMP: Physical Memory Protectionを活用したメモリ分離
 - 図中の点線で囲われているEnclave単位で分離される
 - M modeのSMで一つ
 - REEのLinuxで一つ
 - TEE内に二つ

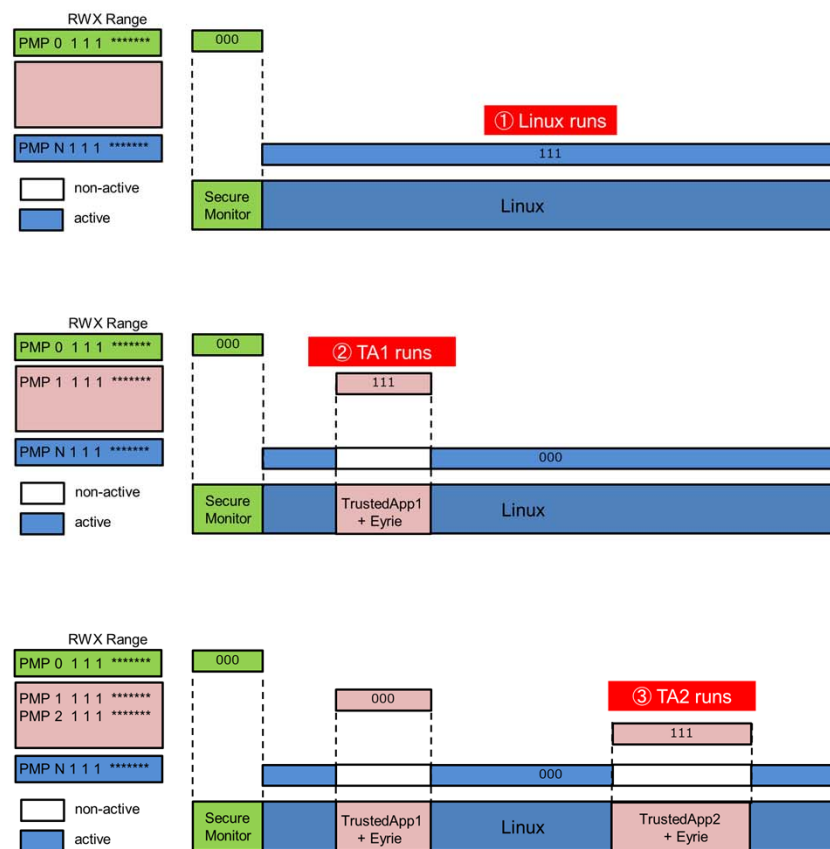
REE: Rich Execution Environment

RISC-V Keystone

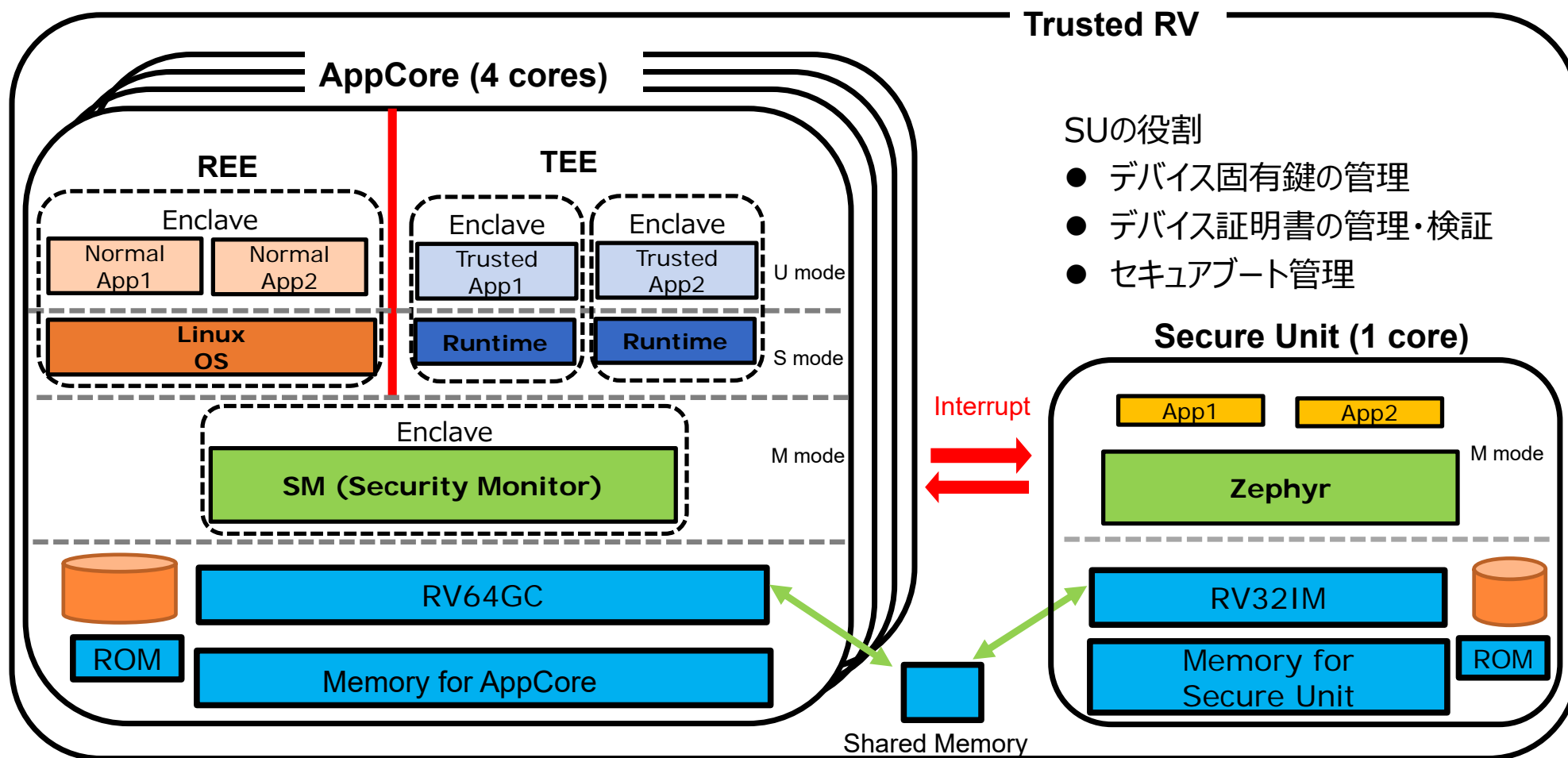
● Keystoneを有効にした場合の起動とPMPの動作



Status of PMP



Trusted-RVプラットフォーム



SUの役割

- デバイス固有鍵の管理
- デバイス証明書管理・検証
- セキュアブート管理

TRASIOが提供する要素技術

- ハードウェア

1. Trusted-RV プラットフォーム (64bit RISC-V + 32 bit RISC-V Secure CoProcessor)

- ソフトウェア

2. TEEのプログラム開発環境 GlobalPlatform TEE Internal API
3. TAの管理フレームワーク TEEP(Trusted Execution Environment Provisioning)
4. Remote Attestation

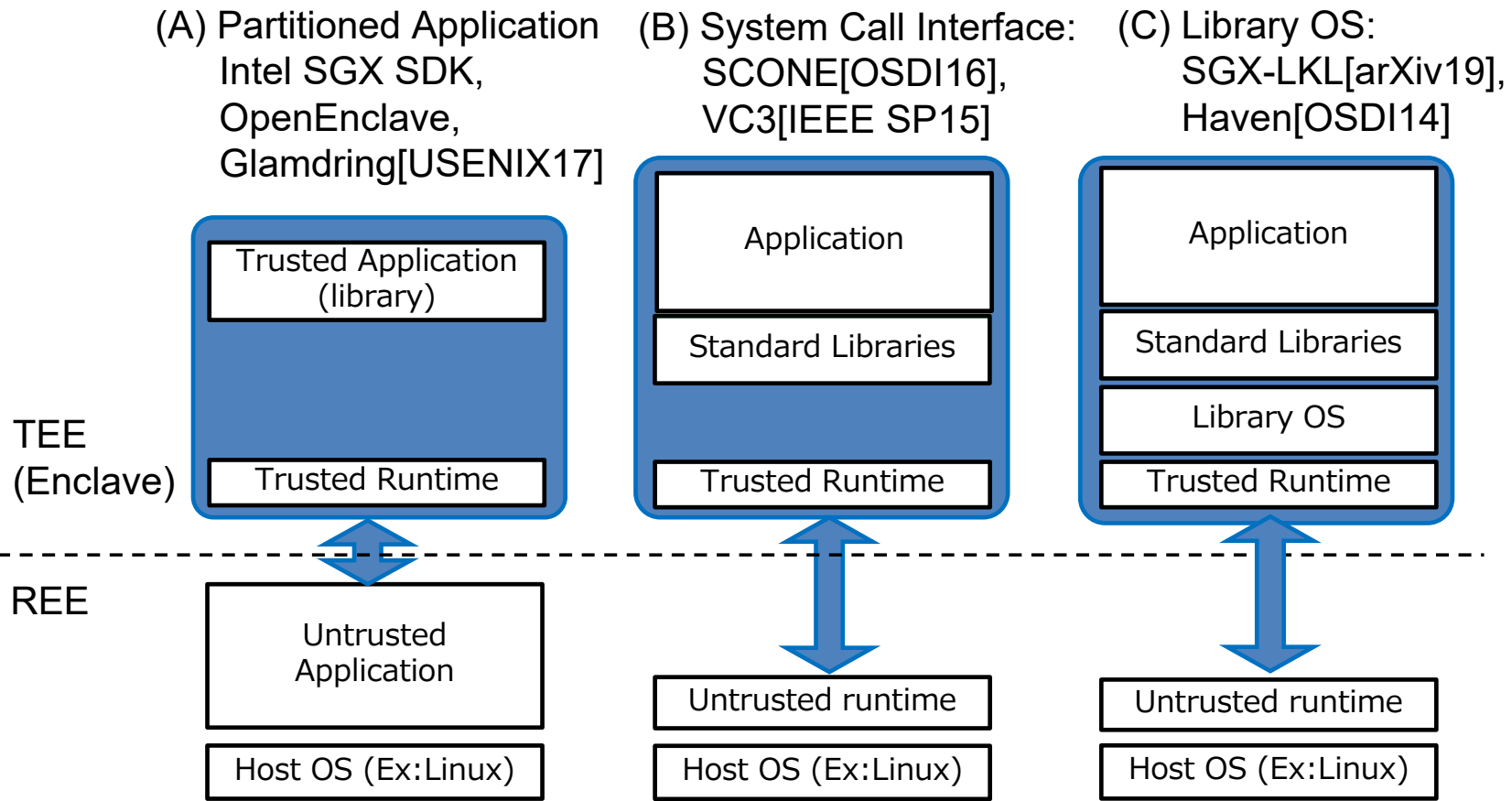
TEE上でシステムソフト実装

同一TEEハードウェアでもシステムソフト実装は**大きく異なる**。
これが引き起こす問題

Intel SGXのシステムソフト

- 代表的な実装
 - Intel SGX SDK
 - Haven[OSDI14]
 - SCONE[OSDI16]
 - Glamdring[USENIX17]
 - SGX-LKL (Linux Kernel Library) [arXiv19]
 - VC3[IEEE SP15]
 - OpenEnclave [Microsoft]
- 抽象化、インターフェースの切り方が異なる

SGX上での実装

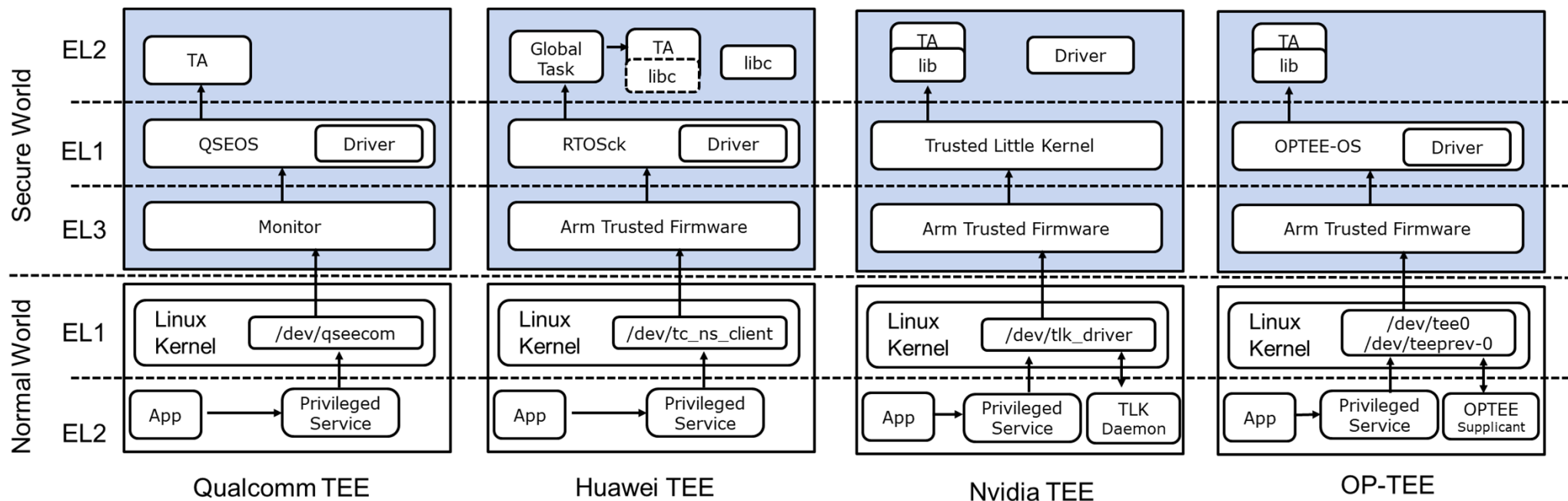


Arm TrustZone上のTrusted OS

- Open Source Trusted OS
 - OP-TEE (Linaro) <https://github.com/OP-TEE>
 - Open-TEE (Aalto University[TrustCom15]) <https://open-tee.github.io/>
 - Trusty (Google) <https://source.android.com/security/trusty/index.html>
 - SierraTEE (Sierra) <https://www.sierraware.com/open-source-ARM-TrustZone.html>
- Enterprise Trusted OS
 - Apple's Secure Enclave
 - Qualcomm's QTEE, ex. QSEE <https://www.qualcomm.com/solutions/mobile-computing/features/security>
 - Samsung's Knox <https://www.samsungknox.com/en>
 - Samsung's Teegris <http://developer.samsung.com/teegris>
 - Trustonic's Kinibi OS, ex. Mobicore/t-base/G&D
 - Huawei's TrustedCore
 - Nvidia's TLK (Trusted Little Kernel)

Arm Cortex-A TrustZone の実装

- Secure WorldのTAのライブラリ実装(Dynamic/Static), Driverの実装などが異なる。
- Normal WorldのDaemon実装やdeviceインターフェースが異なる。



出典: SoK: Understanding the Prevailing Security Vulnerabilities in TrustZone-assisted TEE Systems [IEEE SP20]より

多様なTEEシステムソフトの問題点

- TEEを使いたいサービス提供者側に対する制約
 - TEEではユーザアプリやTrusted AppもTEEシステムソフトの合わせて作る必要がある。
 - ・ 私見：完全仮想化の様にVMに乗るOSが既存のものが変更なく使えれば問題はない。Dockerもカーネルとユーザ空間と言う既存のインターフェースを上手に切って成功した。逆にLibrayOSは切り方の制約(すべてのSysCallが提供できないなど)がアプリにまで及び成功していない。



- 【現状】色々なTEE実装があると対応しきれない。
 - LINE Dev Day 2020のCross-platform Mobile Security at LINEの話
TEEの有用性は理解できるが、デバイスやOSバージョンによってTrusted Applicationの実装方法が異なるのですべてに対応できない。
このため、LINEではWhitebox Cryptographyを使う。
実際に使われているのはAndroidのKeyMaster程度？

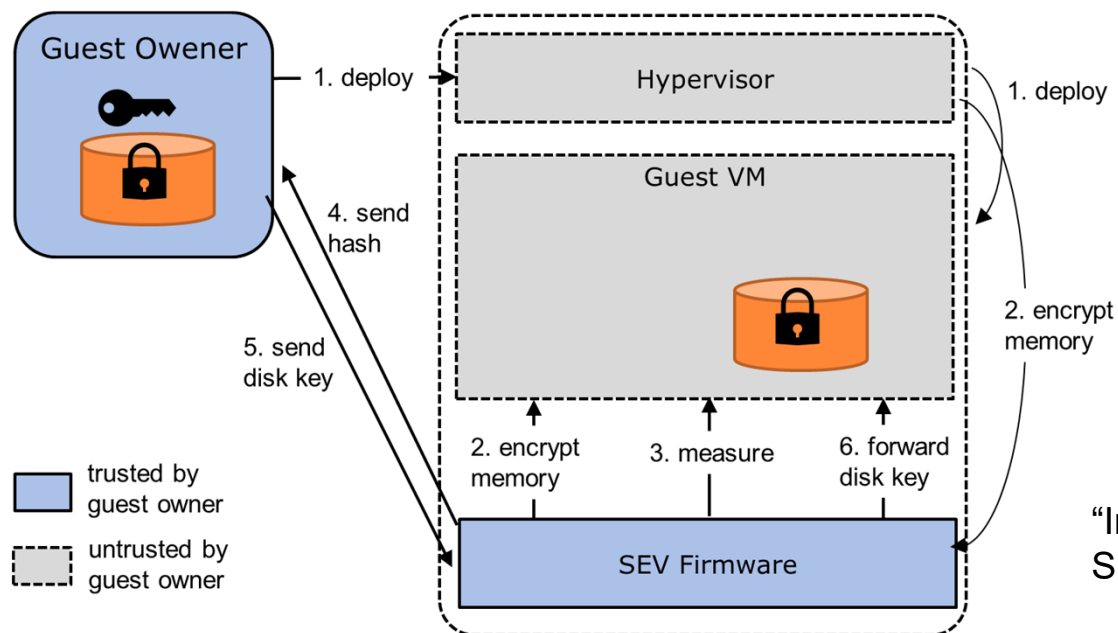
新しい方向：TEEの仮想化対応

- 仮想マシンのTEE化
 - 仮想マシン自体をEnclave/TEEとするもの
- TEE内の仮想化
 - TEE内を仮想化して複数のTrusted OSを実行するもの
- 課題

仮想マシンのTEE化 1/3

● AMD Secure Encrypted Virtualization(SEV)

- 暗号化されたDisk ImageがSEV Firmwareで検証される。
- VM用メモリも暗号化されHypervisorはVMの内容に関知できない。



“Insecure Until Proven Updated: Analyzing AMD SEV’s Remote Attestation” CCS19より

仮想マシンのTEE化 2/3

● Intel Trusted Domain Extensions (TDX)

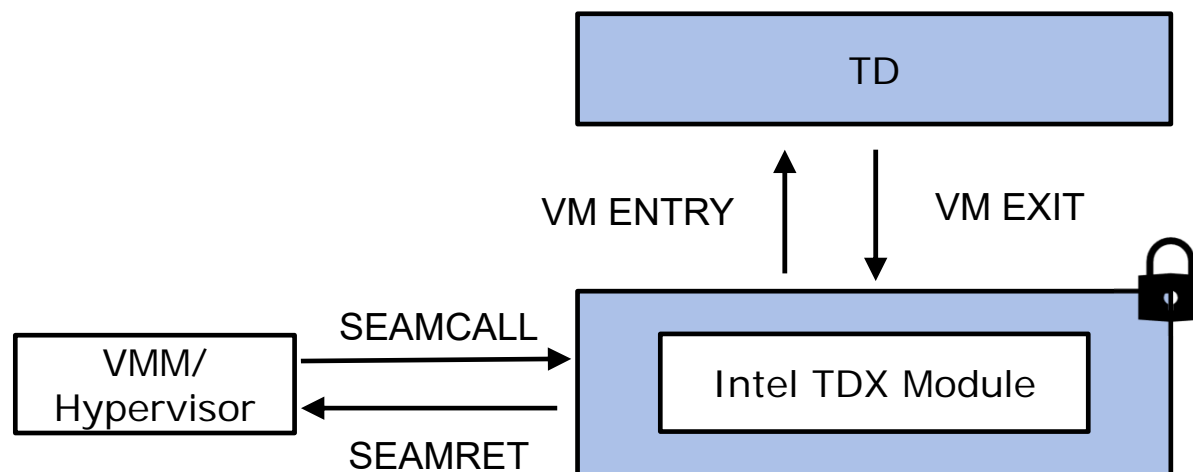
- Intel VT, TXT, SGXを組み合わせてTD (Trusted Domain)の保護
- Secure Arbitration Mode (SEAM)を通して通信

Trusted by TD

- Intel TDC module
- Intel authenticated code (ACM)
- TD Quoting Enclave
- CPU hardware

Untrusted by TD

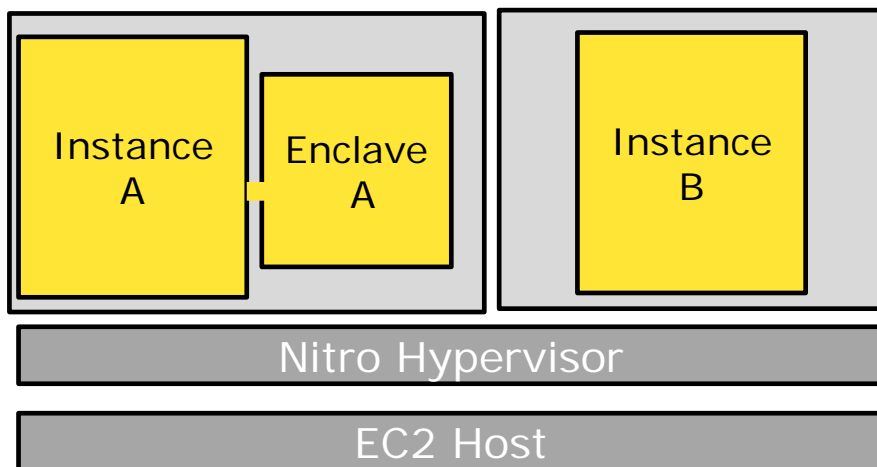
- Platform Admin
- Devices
- All other software
- Platform Firmware
- Host-OS/VMM
- BIOS/SMM



Intel White Paper “Intel Trusted Domain Extensions”より

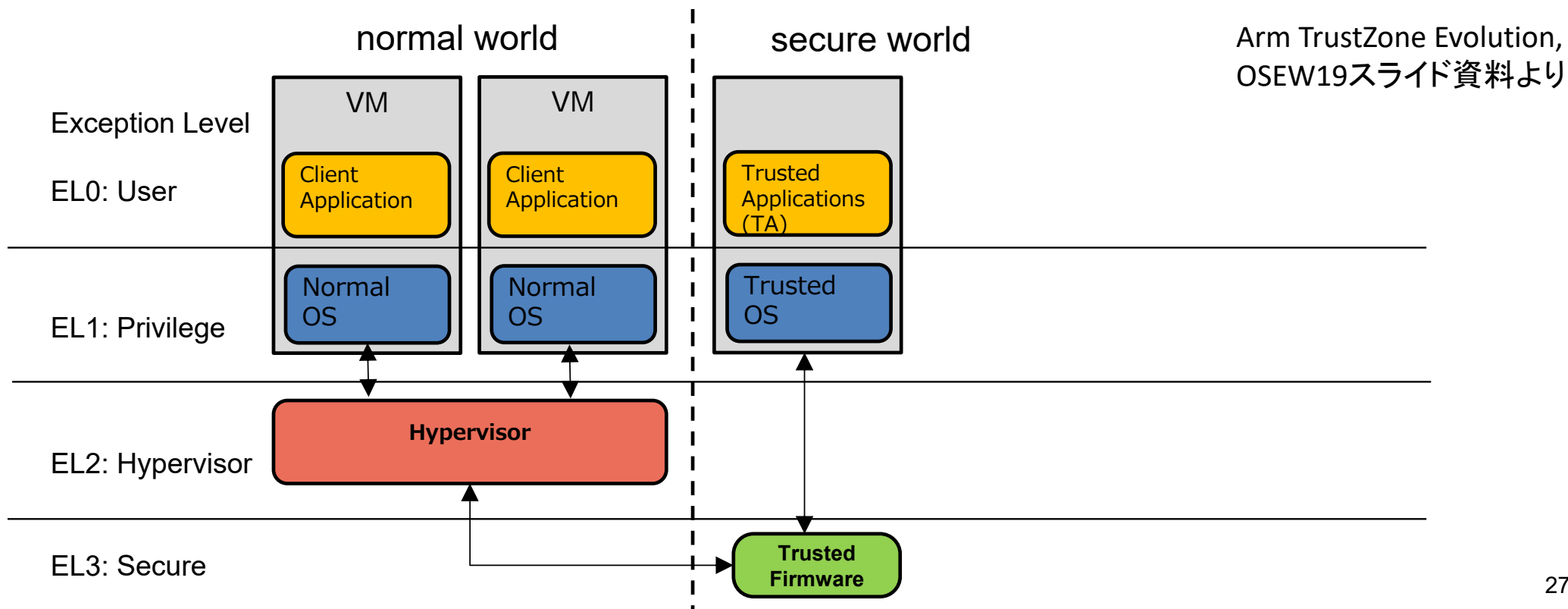
仮想マシンのTEE化 3/3

- Amazon EC2 Nitro
- EC2インスタンスのみに繋がる隔離実行(Enclave)
 - 外部ネットワーク接続も永続的なストレージもない。ローカル仮想ソケット (vsock) のみで通信。
 - Nitro Hypervisor はEnclave を作成する際に構成証明ドキュメント(適切はブート処理の測定値)を作成および署名。これにより改竄検知。
 - <https://aws.amazon.com/jp/ec2/nitro/nitro-enclaves/>
 - <https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-nitro-enclaves-isolated-ec2-environments-to-process-confidential-data/>



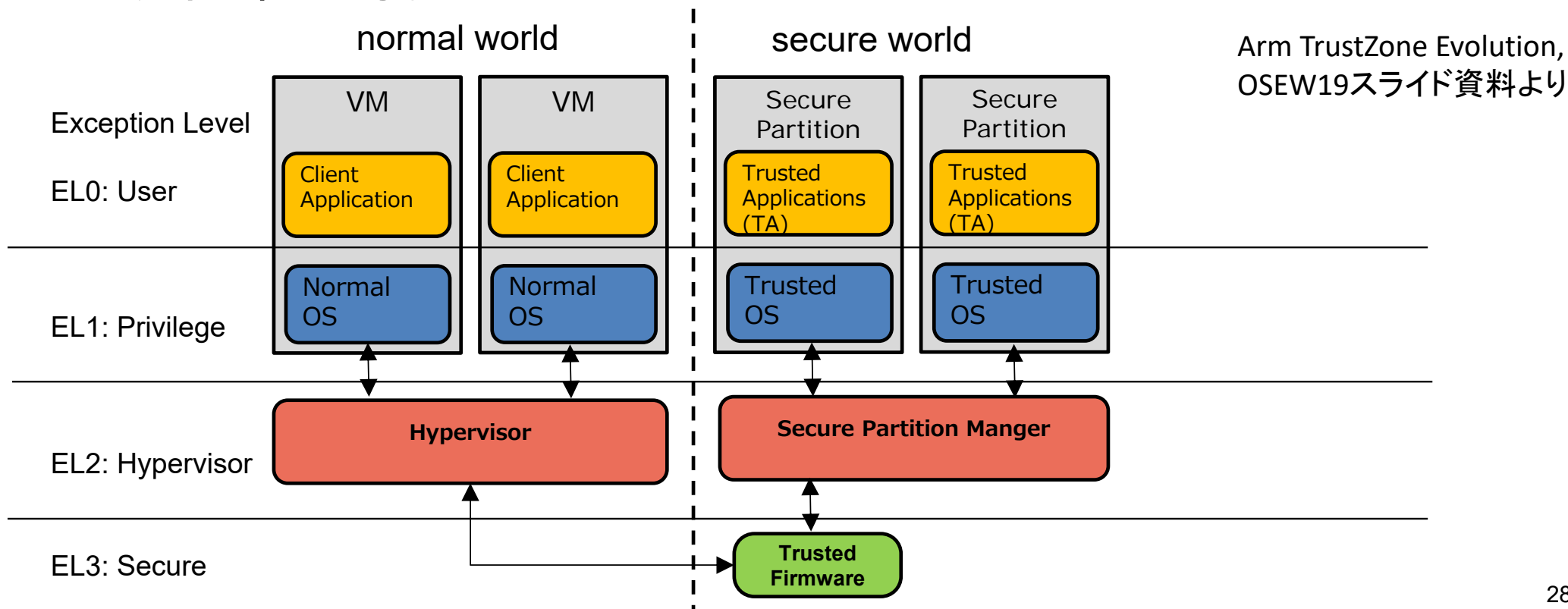
TEE内の仮想化: Arm TrustZoneの進化 (1/3)

● 現状のArm Cortex A



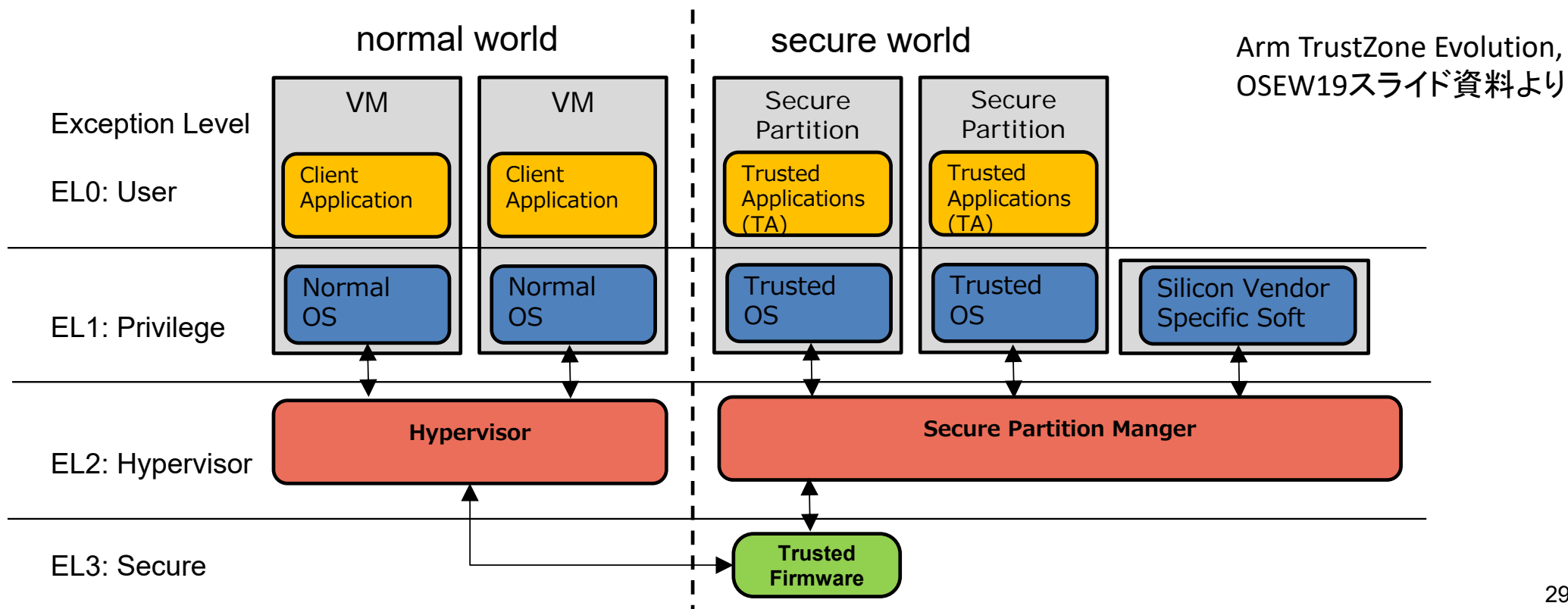
TEE内の仮想化: Arm TrustZoneの進化 (2/3)

- Arm Cortex v8.4A: Secure Partition Mangerが入り、複数のTrusted OSをサポートできる。



TEE内の仮想化: Arm TrustZoneの進化 (3/3)

- Post v8.4A: Silicon Vendor Specific Soft がsecure worldで実行



TEEの仮想化のチャンスと課題

- TEEの仮想化はハードが出た段階で実装研究のチャンスがある。
- 但し、先にTEEのシステムソフト実装の多様性を見せたようにインターフェースの混乱が予想される。
- 実際の活用のためには統一規格が必要。
 - ここが規格争いの主戦場？（後述）



その他の話題

- TEEへのアンチテーゼ
- 関連組織・規格

TEEアンチテーゼ

- 隔離実行はインターフェースを増やし、そのための検査不足から脆弱性を起こす。
- むしろ、すべてを**一元的に管理し、同一レベルの形式検証を適用できるがよい**のではないか。
 - Theseus [OSDI'20]
 - Single Address Space (SAS) is good to remove “state spill”.
 - The compiler of “Rust” can check the whole memory space.



- TEEとREEの通信についてはIntel SGX/RISC-V KeystoneにEnclave Definition Language (EDL)があり、ポインタやバッファのチェックを行っている。

TEE関連組織・規格

- GlobalPlatform
 - TEE関係のAPI規格。スマートフォンで採用が多い。
 - SESIP: Security Evaluation Standard for IoT Platforms
 - CCC: Confidential Computing Consortium
 - Linux Foundationプロジェクト
 - TCG: Trusted Computing Group
 - TPMの仕様を作成している組織。
 - Arm PSA(Platform Security Architecture) Certificate
 - IETF Protocol
 - TEEP: Trusted Execution Environment Provisioning
 - RATS: Remote Attestation Procedures
 - SUIT: Software Updates for Internet of Things
- 規格争い
• 主導権争い

私から見たTEE Research Map



今後の方向性予想

- FPGAでCPU実装が簡単になっており、TEE/仮想化の追加機能ハードウェアを含むOS研究が多くなることを予想。
 - FPGAと低レイヤソフトウェア開発の知識の両方が必要
- 形式検証、安全な言語の活用
 - TEE自体の作成、アプリの作成、TEEインターフェースも厳密にする
- 実用面ではTrusted Appが作りやすい共通インターフェース
 - 規格争い

まとめ

- TEE技術の概観
- TEEの次の方向性：仮想化技術との融合、ハードウェアとの一体開発。

産総研で大学院生のRA(Research Assistant,給与あり)を募集しています。

この成果の一部は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務(JPNP16007)の結果得られたものです。

TEE関連技術の議論を行っているセキュアオープンアーキテクチャ・エッジ基盤技術研究組合(TRASIO)の研究者に感謝します。